

TIS® 300 一款镍/石墨填充的导电导热硅胶片，专为3C电子产品、高频信号设备和精密电磁元件的热管理及电磁干扰抑制而研发。具备优异的导热性能和表面电阻率，同时提供高压缩性与柔软弹性，适用于低压力安装环境。该系列材质有抗流电所产生的腐蚀，并在严苛的环境下保持其稳定性。

特性

- 》良好的热传导率
- 》表面电阻率(Ohm-cm): $< 1.0 \times 10^3$
- 》良好的耐腐蚀性
- 》高可压缩性，柔软兼有弹性，适合于低应力应用

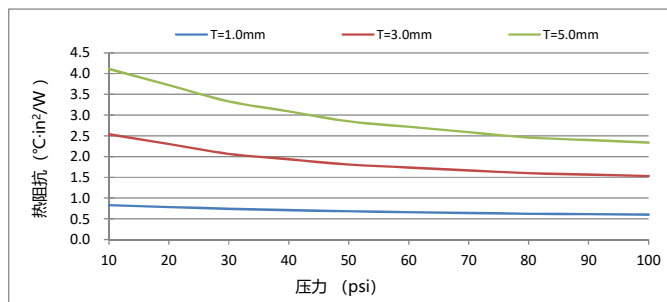
应用

- 》LED照明
- 》3C产品噪音抑制
- 》RAM高次谐波干扰的吸收
- 》Wifi信号改善
- 》手机等信号模式转换的错误率
- 》FPC、IC和其他电子器件的组件，如笔记本电脑。平板电脑等电磁元件噪声抑制

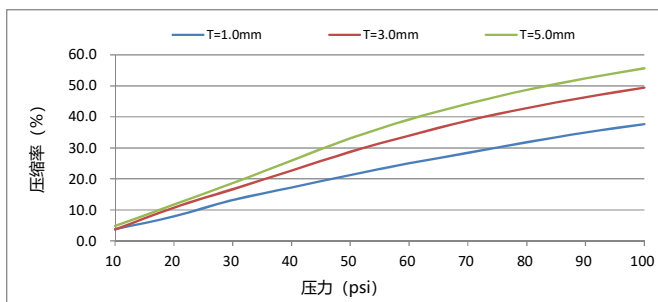
TIS® 300 系列特性表

产品特性	典型值	测试方法
颜色	深灰色	目视
结构&成份	石墨镀镍填充硅橡胶	-
厚度范围 (inch/mm)	0.016~0.200 0.40~5.00	ASTM D374
硬度 (Shore OO)	65	ASTM D2240
密度 (g/cm³)	2.3	ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 200	-
表面电阻率 (Ohm-cm)	$< 1.0 \times 10^3$	ASTM D257
导热系数 (W/m-K)	2.0	ASTM D5470
	2.0	ISO22007
阻燃等级	V-0	UL94 (E331100)

热阻抗



压缩率



产品规格

标准厚度: 0.016" (0.40 mm) ~ 0.200" (5.00 mm)，以 0.010" (0.25 mm) 为增量。
标准尺寸: 10"×16" (254 mm×406 mm)

TIS® 系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

产品型号说明

TIS3 00

厚度: 16mils ~ 200mils
 产品系列

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
 台湾: +886-2-2277-1007
 加拿大: +001-604-2998559
 越南: +84-396852859
 service@ziitek.com
 www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIS300-0326